

## บทที่ 3

### สภาพทั่วไปของบริษัทกรณีศึกษา

บทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงสภาพทั่วไปของบริษัทกรณีศึกษา อาทิประวัติความเป็นมา, นโยบายและพันธกิจบริษัท, โครงสร้างองค์กร, ผลิตภัณฑ์และลูกค้าของบริษัท และรวมถึงการนำเสนอข้อมูลทั่วไปที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของบริษัทกรณีศึกษา

#### 3.1 ประวัติความเป็นมา

บริษัทกรณีศึกษาดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านยานอวกาศ ดาวเทียม ยุทธวิธีอุปกรณ์ทางการแพทย์ คอมพิวเตอร์ การคมนาคม การแพทย์ การอุตสาหกรรม-บันเทิง ซึ่งเป็นผู้นำทางการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในโลก ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Surface Mounting Technology (SMT) เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง มากกว่า 20,000 ชิ้นต่อวัน มีเตาอบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยรับประกันว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นจะติดแน่นบนแผงวงจร โดยผ่านกระบวนการ Solder Reflow และการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานโดยการใช้ AOI (Automated Optical Inspection) ก่อนการทดสอบด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบแผงวงจรเพื่อประกันคุณภาพของกระบวนการผลิต และขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการทดสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ให้ทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานต่างๆ นั้นอาศัยปรัชญาการทำงานที่เน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คุณภาพสูง ตรงต่อเวลา และราคาที่เหมาะสม ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนจาก BOI ที่เป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออก 100% จึงไม่ต้องเสียภาษีจากการนำเข้าวัตถุดิบ ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 1993 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมโลก ISO9000, การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9002 และการรับรองคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ผู้บริโภคความใจทั้งด้านคุณภาพและบริการเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการประกอบกิจการของบริษัทต้องไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ต่อมาในเดือนเมษายนปี 1994 บริษัทกรณีศึกษาได้รับการรับรอง BABT (British Approval Board for Telecommunication) จึงส่งผลให้บริษัทขยายธุรกิจไปทำการค้าและประเทศในภาคยุโรปได้อีก

### 3.1.1 นโยบายและพันธกิจของบริษัท

เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดได้ให้แนวทางแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรตระหนักตรงกันว่า บริษัทต้องเป็นผู้นำอันดับหนึ่งทางการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly) ดังนั้นกลุ่มผู้บริหารจึงมีนโยบายและชี้แจงพันธกิจของบริษัทดังนี้

1. นโยบายบริษัท เราจะให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีเลิศ และส่งทันตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2. พันธกิจบริษัท เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดที่จะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของบริษัทผู้ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly) พันธกิจบริษัทจึงกำหนดไว้ดังนี้

2.1 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด (Focus Total Customer Satisfaction) เพื่อรักษาลูกค้าไว้กับบริษัทให้นานที่สุด

2.2 มีระบบคุณภาพที่สูงสุด (High Quality) รากฐานระบบการควบคุมมาตรฐานต้องเข้มงวด

2.3 ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดที่นัดหมาย (On Time Delivery) อันเป็นหลักประกัน การซื้อขายให้กับลูกค้า

2.4 ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด (Lowest Total Cost)

2.5 การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ (Continuous Process Improvement)

### 3.1.2 ผลิตภัณฑ์และลูกค้าของบริษัท

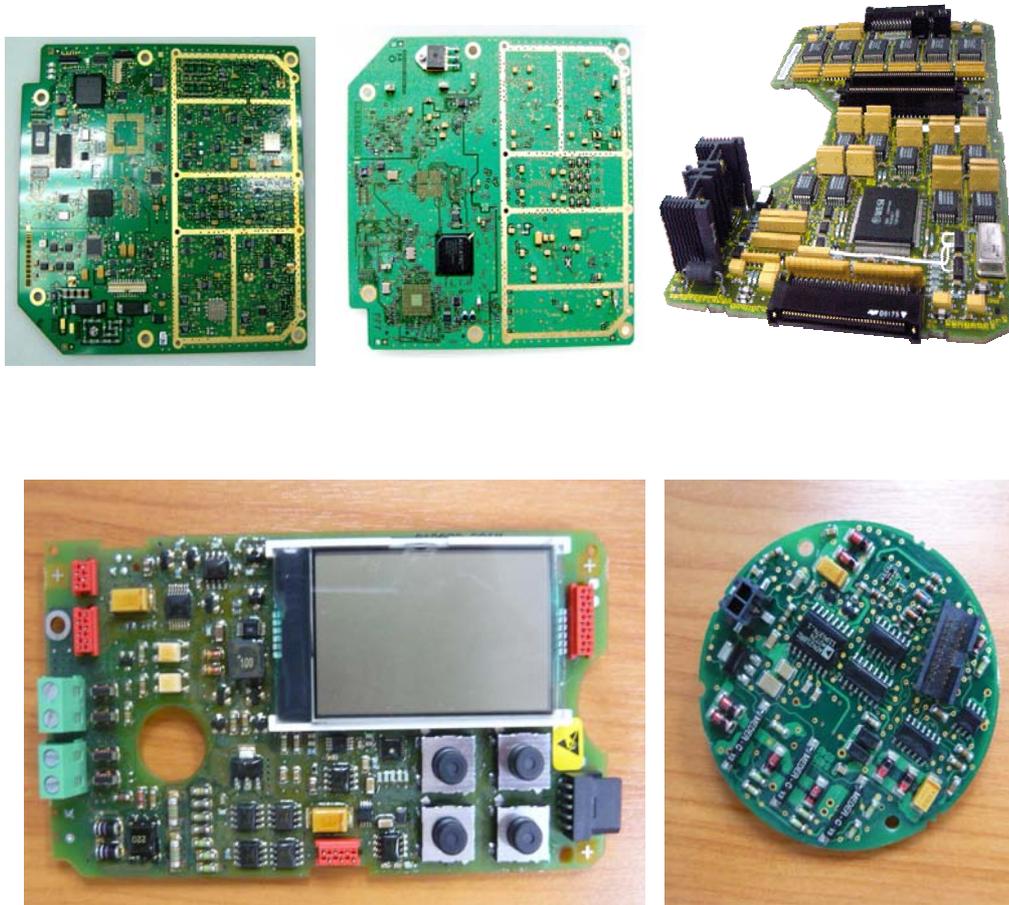
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นภาพแบบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly) ประมาณ 70% และเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Box Build) อีก 30% ซึ่งมาจากลูกค้ายุโรปและอเมริการวมกัน 90% และลูกค้าภูมิภาคอื่นๆ อีก 10%

เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ โดยไม่ได้มีตราสินค้าเป็นของตัวเอง ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบเสร็จ (Printed Circuit Board Assembly) พร้อมประกอบเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาชีพสินค้าตัวอย่างเช่น

1. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยการรับจ้างผลิตให้กับผู้ออกแบบเพื่อนำไปวางจำหน่าย

2. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการคมนาคมการสื่อสารทั่วไป (Datacom และ Telecom)

3. แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านการบันเทิงทุกประเภท (Media)
4. แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมโรงงานที่ต้องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (Industrial)
5. แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ (Consumer)
6. แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยุทธโธปกรณ์ที่ใช้ในการทหาร (Military และ Aerospace)



ภาพที่ 3.1  
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท

### 3.1.3 คู่ค้าที่สำคัญของบริษัท

ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ที่บริษัทกรณีศึกษาดำเนินธุรกิจด้วยล้วนแต่เป็นรายสำคัญทั้งสิ้น ซึ่งการตัดสินใจก่อนการร่วมลงทุนนั้นจะต้องได้รับการประเมินมูลค่าการลงทุนรายปีเฉลี่ย มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (2.0 Million USD) ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

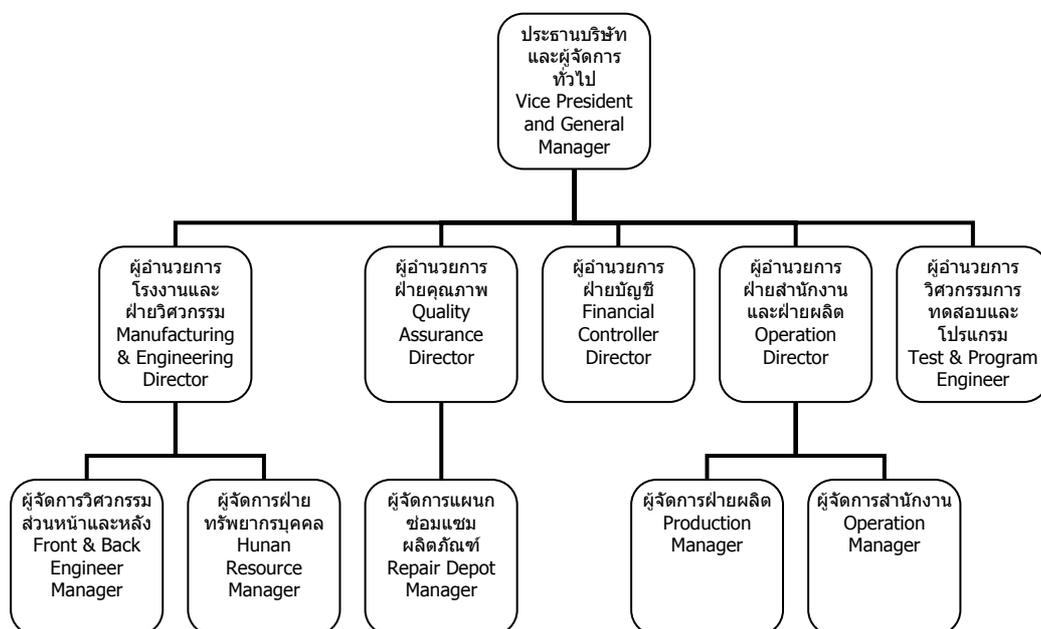
1. Hewlett Packard เป็นผู้ผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสารและอื่นๆ เพื่อส่งไปยังประเทศในแถบมาเลเซีย เม็กซิโก อเมริกา และยุโรป
2. Network Computing Device เป็นบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่ในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบที่ใช้กับระบบ Mainframe
3. LSI Logic เป็นบริษัทที่ออกแบบแผงวงจรที่ใช้เป็น Card memory ที่ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
4. Microsemi เป็นบริษัทที่ผลิตแผงวงจรที่ใช้กับรถยนต์ ซึ่งมีลูกค้าแถบยุโรป
5. AMI เป็นบริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีของหน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความสามารถในการประมวลผลเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล (Raid)
6. Schindler เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์จำพวกลิฟต์ และบันไดเลื่อน
7. Thales เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับชิ้นส่วนอากาศยาน
8. Alcatel เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นนำ
9. ในปัจจุบันบริษัทมีคู่ค้าเพิ่มขึ้นเช่น Engineo, Flextronics, Overland, Mcddata, Ezurio และ Ikor



ภาพที่ 3.2

ลูกค้าหลักของบริษัท

### 3.1.4 โครงสร้างองค์กรของบริษัท



ภาพที่ 3.3

โครงสร้างองค์กรของบริษัท

### 3.2 การพิจารณาสัดส่วนผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาได้ใช้สิน เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร ซึ่งได้ทำการปรับปรุงส่วนของกระบวนการผลิตแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มในส่วนของสำนักงาน ฉะนั้นในการศึกษาวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการปรับปรุงในส่วนการบริหารจัดการเฉพาะส่วนสำนักงานเท่านั้น โดยใช้กรณีศึกษาสินค้าของลูกค้ารายหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ลำดับต่อไปจะพิจารณาสัดส่วนปริมาณยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ เพื่อค้นหากลุ่มสินค้าสำหรับการทำงานวิจัย สินค้าของลูกค้ารายนี้ที่ทำการผลิตในปัจจุบัน สามารถจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

#### 1) สินค้าเทเลคอมมิวนิเคชัน (Telecommunication) กลุ่ม A

- รุ่น A-MAIN
- รุ่น A-Extension
- รุ่น A-Plug In
- รุ่น A-Upgrade Kit

## 2) สินค้าเทเลคอมมิวนิเคชัน (Telecommunication) กลุ่ม B-V1

- รุ่น B-V1 I
- รุ่น B-V1 II
- รุ่น B-V1 III
- รุ่น B-V1 IV
- รุ่น B-V1 V

## 3) สินค้าเทเลคอมมิวนิเคชัน (Telecommunication) กลุ่ม B-V2

- รุ่น B-V2 I
- รุ่น B-V2 II

## ตารางที่ 3.1

ปริมาณยอดสั่งซื้อแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบเสร็จ (Printed Circuit Board Assembly)

จากข้อมูลพยากรณ์คำสั่งซื้อของลูกค้าเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551

ความต้องการเดือน	รุ่น A	รุ่น B-V1	รุ่น B-V2	ปริมาณรวม
1 ตุลาคม 2550	4,200	8,960	-	13,160
1 พฤศจิกายน 2550	4,080	8,320	-	12,400
1 ธันวาคม 2550	3,880	6,720	1,690	12,290
1 มกราคม 2551	3,740	7,030	2,220	12,990
1 กุมภาพันธ์ 2551	3,810	8,100	3,820	15,730
1 มีนาคม 2551	4,240	8,320	4,640	17,200
1 เมษายน 2551	4,320	10,240	5,660	20,220
1 พฤษภาคม 2551	4,400	11,720	6,060	22,180
1 มิถุนายน 2551	4,560	11,830	6,380	22,770
1 กรกฎาคม 2551	4,660	12,200	6,820	23,680
1 สิงหาคม 2551	4,700	12,610	6,700	24,010
1 กันยายน 2551	4,760	12,410	6,770	23,940
<b>ปริมาณรวม</b>	<b>51,350</b>	<b>118,460</b>	<b>50,760</b>	<b>22,0570</b>

จากข้อมูลพยากรณ์ข้างต้นพบว่ากลุ่มสินค้า B-V1 มีปริมาณการสั่งซื้อสูงสุด ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะทำการดำเนินการวิจัยสินค้ากลุ่มนี้ และจะทำการค้นหาสินค้าเพื่อพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมายโดยทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญสูงสุด ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ (Product Quantity (PQ) Analysis) ในการปรับปรุงในบทถัดไป